(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Bureau international

(43) Date de la publication internationale
8 juillet 2004 (08.07.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2004/057670 A1

(51) Classification internationale des brevets[7] :
H01L 23/522, 23/043, 23/06, 23/498, 23/36

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/EP2003/050964

(22) Date de dépôt international :
8 décembre 2003 (08.12.2003)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
02/16363 20 décembre 2002 (20.12.2002) FR

(71) Déposant *(pour tous les États désignés sauf US)* : **THALES** [FR/FR]; 45, rue de Villiers, F-92526 Neuilly sur Seine (FR).

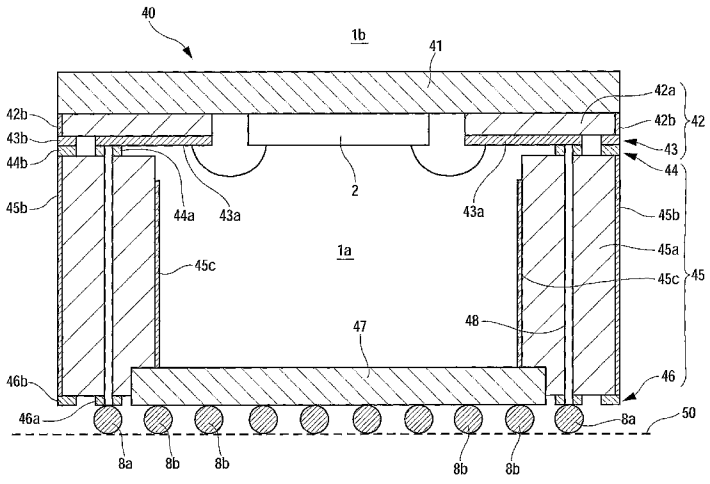
(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants *(pour US seulement)* : **KERTESZ, Philippe** [FR/FR]; THALES, Intellectual Property, 31-33 Avenue Aristide Briand, F-94117 Cedex Arcueil (FR). **LEDAIN, Bernard** [FR/FR]; THALES, Intellectual Property, 31-33 Avenue Aristide Briand, F-94117 Cedex Arcueil (FR). **CABAN-CHASTAS, Daniel** [FR/FR]; THALES, Intellectual Property, 31-33 Avenue Aristide Briand, F-94117 Cedex Arcueil (FR).

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: SURFACE-MOUNTED MICROWAVE PACKAGE AND CORRESPONDING MOUNTING WITH MULTILAYER CIRCUIT

(54) Titre : BOITIER HYPERFREQUENCE A MONTAGE DE SURFACE ET MONTAGE CORRESPONDANT AVEC UN CIRCUIT MULTICOUCHE



(57) **Abstract:** The invention relates to a microwave package defining an inner volume. The inventive microwave package comprises at least: one Faraday cage which is formed by a conductive surface (1, 5, 3e) surrounding the aforementioned inner volume; a connection point (8a) which is disposed outside the Faraday cage, said connection point being intended to be electrically connected to an external circuit; an input/output which passes through the Faraday cage and which is connected electrically to the connection point; a base (3) which forms one face of the package, the outer surface of the base forming one mounting surface which is intended to be applied to the external circuit. Moreover, the connection point is placed on the mounting surface such that said connection point is disposed between the Faraday cage and the external circuit when the package is mounted to the external circuit. The invention relates to microwave packages which are used in the avionics, telecommunications and space fields.

(57) **Abrégé :** L'invention concerne un boîtier hyperfréquence délimitant un volume intérieur, comprenant au moins: une cage de Faraday formée par une surface conductrice (1, 5, 3e) entourant le volume intérieur, un point de connexion (8a) placé à l'extérieur cage de Faraday, le point de connexion étant destiné à être relié électriquement

[Suite sur la page suivante]

WO 2004/057670 A1

(74) **Mandataires : LUCAS, Laurent** etc.; THALES, Intellectual Property, 31-33 Avenue Aristide Briand, F-94117 Cedex Arcueil (FR).

(81) **États désignés** *(national)* **:** AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) **États désignés** *(régional)* **:** brevet ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

— *avec rapport de recherche internationale*

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

à un circuit extérieur, une entrée-sortie traversant la cage de Faraday et reliée électriquement au point de connexion, une base (3) formant une face du boîtier, la surface extérieure de la base formant une surface de montage destinée à être appliquée sur le circuit extérieur, le point de connexion étant placé sur la surface de montage, de sorte que le point de connexion est placé entre la cage de Faraday et le circuit extérieur lorsque le boîtier est monté sur le circuit extérieur. L'invention s'applique aux boîtiers hyperfréquences utilisés dans les domaines de l'avionique, des télécommunications, du spatial.